



三井金属鉱業株式会社

三井金属

東京都品川区大崎 1-11-1

郵便番号 141-8584

報道各位

平成 14 年 1 月 1 0 日

三井金属 30 μ mピッチ対応のCOF 量産体制を確立

当社 三井金属（社長 宮村眞平）は、2層材料を使用して30 μ mピッチまでのファインパターンを形成したCOF（Chip On Film）を開発し、一部サンプル出荷を開始するとともに、その量産体制を確立致しました。

COFは、当社が従来生産している3層TAB（Tape Automated Bonding）テープに比べ、IC接続用穴（デバイスホール）が無く、インナーリードをフィルムで保持したものです。IT製品において、配線パターンのファインピッチ化が進行する中、インナーリードも薄くかつ細くなる傾向にあり、フィルムによりその変形が防止されたCOFは、配線ピッチの高密度化に極めて有効です。

今回確立された30 μ mピッチまでのパターン形成技術は、これまでの3層TABテープでは40 μ mピッチまでが対応の限界であったのに対し、その配線ピッチの高密度化を飛躍的に進め得るものとなります。実際、これまでTABの使用が主流であったLCDドライバー用テープにもCOF構造のものが採用され始めており、今後のファインピッチへの動きにも対応が可能となります。

また、COFのベース材料としましては、キャスト法、メッキ法等により製造された各種2層材料に対応が可能です。更に当社は、需要家での実装歩留まり向上やコストダウンのため、COF製造プロセス改善および材料メーカーとの新規2層材料の開発等を図ってまいります。

【ご参考】

- ・ キャスト法2層材料 ... 電解銅箔にポリイミド原料を塗布、熱処理をして銅箔付きポリイミドフィルムとしたもの
- ・ メッキ法2層材料 ... ポリイミドフィルム上に電解メッキにより銅箔を形成して銅箔付きポリイミドフィルムとしたもの

以 上

【本件お問い合わせ先】

三井金属 経営企画部広報室

鹿江政二

Telephone 03- 5437-8028

マイクロサーキット事業部

築城修治

Telephone 03- 5437-8108